

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-046

## 深南电路股份有限公司

### 关于投资建设广州封装基板生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资项目概述

根据公司经营及中长期战略发展需要，为进一步强化公司技术实力、巩固行业地位，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于投资建设广州封装基板生产基地项目的议案》，公司拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本投资事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、投资项目基本情况

公司拟在广州设立封装基板生产基地，具体情况如下：

1、主要产品：FC-BGA、FC-CSP及RF封装基板

2、投资规模：项目总投资约人民币60亿元，其中固定资产投资总额累计不低于58亿元，项目一期固定资产投资不低于38亿元，项目二期固定资产投资不低于20亿元。项目整体达产后预计产能约为2亿颗FC-BGA、300万panel RF/FC-CSP等有机封装基板。

3、项目地点：广州市开发区中新广州知识城内

4、项目资金来源：自有资金及自筹资金

### 三、项目投资的目的及对公司的影响

封装基板是集成电路封装的重要材料，为芯片提供支撑、散热和保护，广泛应用于手机、数据中心、消费电子、汽车等领域。

#### 1、封装基板产品具有广阔的市场前景

随着5G建设及应用的逐步推进，数据中心、智能驾驶、AI、高性能计算等领域需求热度持续高涨，其所需的主要核心IC（CPU，GPU，FPGA，ASIC）市场规模迎来高速增长的机会。同时，随着5G手机等终端数量逐年增加，手机等智能终端所需的应用处理器、射频模组等IC需求也稳步增长。封装基板作为集成电路封装的核心材料之一，具有广阔的市场前景。

#### 2、满足公司战略发展目标，提升行业竞争力

公司经过多年的运营，在封装基板领域积累丰富的经验，在不同的半导体下游市场应用领域配套国内外客户需求。建设封装基板项目是公司实现中长期发展目标的重要举措，有利于公司快速抓住市场机遇，加快产业布局，进一步提升公司在高端封装基板市场的竞争力。

本次投资有利于满足公司业务扩展及产能布局的扩张，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、存在的风险及应对方式

因不可抗力或客观原因影响，可能存在不能按照项目建设周期及进度进行施工的风险。公司将合理安排工期，确保该项目建设如期完成。

本次投资涉及的投资规模相对较大，对公司的项目管理、资金管理能力提出较高的要求，存在一定的项目资金安排及管理风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

FC-BGA为高阶封装基板产品，具备高多层、高精细线路等特性，有较高的技术壁垒，存在一定技术风险。公司现有工厂已具备FC-CSP基板的批量生产能力，有较完善的精细线路产品技术能力以及质量能力平台，FC-BGA基板技术将

在现有平台基础上进行深度孵化；公司也将积极引入该领域的技术专家人才，加快工艺制程开发。

项目所涉及的原材料、设备主要依赖于进口，如因外部政治经济环境变化，有可能导致部分原材料、设备存在供应风险。公司已与主要原材料供应商达成合作意向，将积极保障原材料供应；项目建设所需主要设备主要由现有的成熟供应商提供，公司与供应商合作稳定，将继续与供应商保持良好合作关系，确保设备按期交付。

封装基板人才培养周期长，如果人才经验背景及技术经验积累不能够快速更新换代，将无法匹配行业及公司的发展要求。经过10多年的发展，公司已形成了一批专业基板人才，公司针对该项目所需的人才已重点开展储备工作。公司将持续完善多维度的激励体系，打造后备梯队人才资源池，提升自主培养人才的综合能力，为未来发展提供智力支持。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十三日